

武汉光庭信息技术股份有限公司 关于公司签署《和解协议》的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、签署和解协议的背景介绍

武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）长期为延锋伟世通电子科技（上海）有限公司及延锋伟世通电子科技（南京）有限公司（以下合并简称“客户”或“延锋伟世通”）提供汽车电子软件工程项目及技术服务，因客户未能及时回款，使得客户欠付公司的款项在公司形成账龄较长的大额应收账款。

基于市场环境及客户经营状况，为了保障公司利益，加快应收账款回收，双方经多次沟通协商，同意就欠付款项及仲裁案件的处理与公司达成和解。公司于2024年12月26日召开公司第三届董事会第二十八次会议，同意公司与延锋伟世通签署《和解协议》。该事项尚需提请公司股东大会审议批准。

根据《和解协议》的约定，协议自各方签署之时成立，并于客户在2024年12月31日前支付了100万元且公司股东会审议批准后生效。

具体内容详见公司于2024年12月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司签署<和解协议>的公告》（公告编号：2024-067）。

二、进展情况及风险提示

2024年12月27日，根据《和解协议》约定，公司收到了客户以票据方式支付的第一期和解金100万元；2025年1月15日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了相关事项。公司与客户签署的《和解协议》达成了“协议于客户在2024年12月31日前支付了100万元且公司股东会审议批准后生效”的条件，《和解协议》于2025年1月15日正式生效。

协议生效后客户能否如期支付相关款项存在不确定性，公司后期将督促对方按照协议履约，积极维护公司的利益，并按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司

董事会

2025年1月16日